



SpaceX锁定英伟达GPU供应推进算力基建， 三星发布AI存储技术路线图

AI算力行业周报

投资评级：推荐（维持）

报告日期：2026年08月10日

- 分析师：庄宇
- SAC编号：S1050525120003
- 联系人：石俊烨
- SAC编号：S1050125060011

研究创造价值

马斯克宣布SpaceX将独家采用英伟达芯片，2027年算力目标近10GW

当地时间8月4日，特斯拉与SpaceX CEO埃隆·马斯克在财报会议上宣布，SpaceX未来的人工智能（AI）基础设施将完全独家采用英伟达的芯片与技术。

马斯克明确指出，SpaceX决定在未来AI基础设施建置上完全独家使用英伟达产品，原因在于英伟达的Vera Rubin构架是目前市场上最优秀的AI构架。目前，SpaceX已与英伟达达成共识，2027年将取得英伟达非常显著比例的GPU供应。算力扩张计划方面，SpaceX预计2026年底将拥有超过2 GW的算力，而到2027年底累计上线算力将接近10 GW，远高于5 GW的业界水平。

三星公布AI存储路线图，zHBM性能较HBM5提升4-8倍

8月4日，三星电子于2026年未来存储大会（FMS 2026）上展示其面向AI和高性能计算（HPC）的最新3D存储产品组合与技术路线图，首度公开zHBM与zNAND-O概念模型，并推出业界首款层数超过400层的V10 BV-NAND。

zHBM专为先进AI运算设计，打破HBM置于处理器旁的传统设计，改将HBM直接垂直堆叠在AI加速器上方，预估性能可达HBM5的4至8倍。通过下一代晶圆键合技术，zHBM内存密度较HBM5提升10倍以上，能源效率提升3倍，热阻降低50%以上，且支持定制化设计，允许客户在夹层中整合专属IP。

zNAND-O基于V-NAND技术，提供4层和8层两种配置，专为边缘AI环境优化，具备高空间效率、低延迟与强大I/O性能，可支持即时且数据密集型的AI应用。三星还推出V10 BV-NAND，采用晶圆键合技术，层数高达400层以上，存储密度较前代V9大幅提升约58%，读写、I/O性能与能源效率皆有显著提升。

建议关注：兴森科技、长鑫科技、东材科技、华虹宏力。

重点关注公司及盈利预测

公司代码	名称	2026-08-10 股价	EPS			PE			投资评级
			2025	2026E	2027E	2025	2026E	2027E	
002436.SZ	兴森科技	33.44	0.08	0.26	0.44	418.00	128.62	76.00	买入
601208.SH	东材科技	45.38	0.28	0.66	0.97	162.07	68.76	46.78	买入
688347.SH	华虹宏力	264.00	0.01	0.51	0.83	26400.00	517.65	318.07	增持
688825.SH	长鑫科技	51.30	0.03	2.17	3.66	1710.00	23.64	14.02	买入

资料来源：Wind，华鑫证券研究

中美“关税战”加剧风险

中美科技竞争加剧风险

先进制程进度不及预期风险

AI模型大厂资本开支不及预期风险

目录

CONTENTS

1. 算力板块周度行情分析
2. 行业动态
3. 公司公告

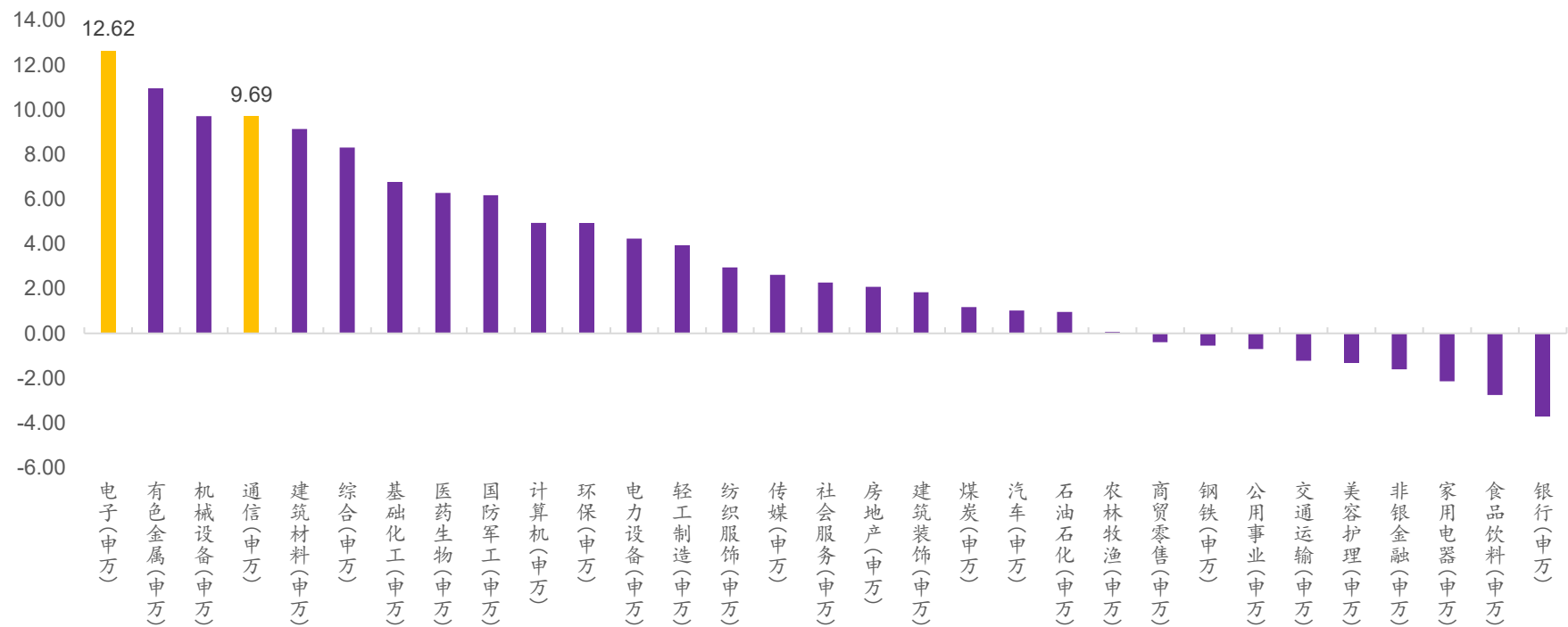
01 算力板块周度行情分析

研究创造价值

1.1、申万一级行业周涨跌幅

跨行业比较，8月3日-8月7日当周，申万一级行业整体呈分化态势。其中电子行业上涨12.62%，位列第1位；通信行业上涨9.69%，位列第4位。

图表2：8月3日-8月7日申万一级行业周涨跌幅比较（%）

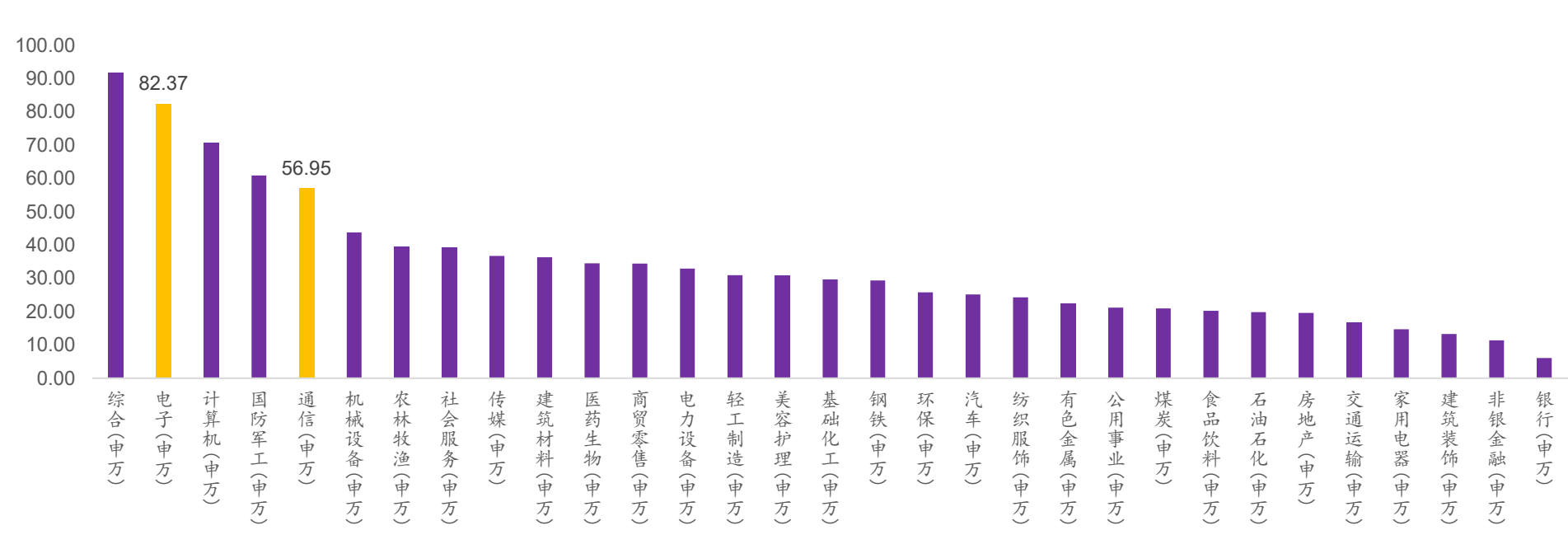


资料来源：wind，华鑫证券研究

1.2、申万一级行业估值水平

跨行业比较，8月3日-8月7日当周，估值前三的行业为综合，电子和计算机行业，其中电子、通信行业的市盈率分别为82.37，56.95。

图表3：8月3日-8月7日申万一级行业市盈率比较

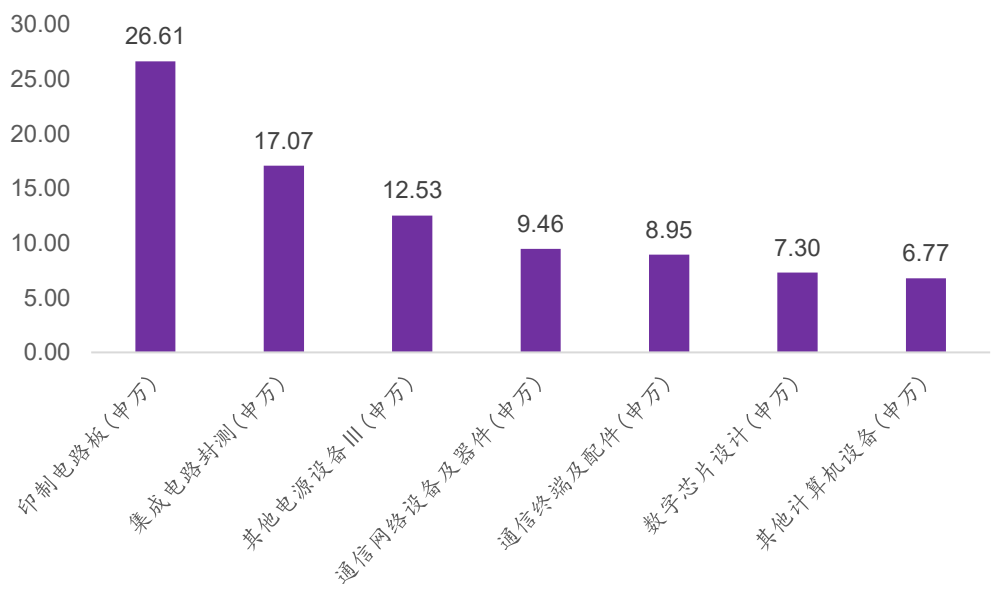


资料来源：wind，华鑫证券研究

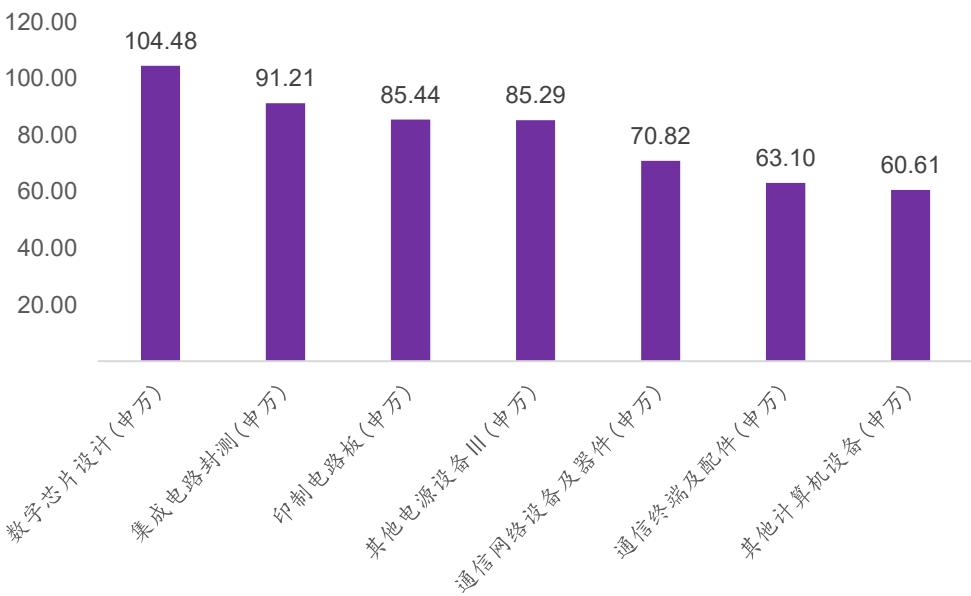
1.3、AI算力细分板块周度行情梳理

AI算力相关细分板块比较，8月3日-8月7日当周，AI算力相关细分板块呈上涨态势。其中，印制电路板板块涨幅最大，达到26.61%。其他计算机设备板块涨幅最小，达到6.77%。估值方面，数字芯片设计、集成电路封测和印制电路板板块估值水平位列前三。

图表4：8月3日-8月7日AI算力相关细分板块周涨跌幅比较（%）



图表5：8月3日-8月7日AI算力相关细分板块市盈率比较



资料来源：wind，华鑫证券研究

1.4、申万一级行业板块资金流向

上周申万一级行业资金流向情况：

上周通信板块主力净流入164.05亿元，主力净流入率为1.52%，在31个申万一级行业中排第1名；电子板块主力净流入431.55亿元，主力净流入率为1.24%，在31个申万一级行业中排第5名。

图表6：8月3日-8月7日申万一级行业资金流向情况

行业	主力流入额(万元)	主力流出额(万元)	主力净流入额(万元)	主力净流入率(%)	连续流入天数
SW通信	50,672,852.90	49,032,328.57	1,640,524.33	1.52	-1
SW有色金属	25,768,833.69	24,628,961.08	1,139,872.61	1.52	1
SW建筑材料	6,288,932.21	6,040,058.99	248,873.22	1.31	4
SW机械设备	27,166,405.28	26,042,238.47	1,124,166.81	1.29	5
SW电子	142,653,894.72	138,338,421.61	4,315,473.10	1.24	1
SW医药生物	18,742,504.81	18,346,135.28	396,369.53	0.60	2
SW电力设备	26,381,308.83	26,020,630.21	360,678.62	0.41	1
SW基础化工	14,405,695.16	14,190,645.19	215,049.96	0.39	3
SW银行	5,243,663.51	5,192,865.69	50,797.82	0.30	1
SW建筑装饰	3,888,824.45	3,843,178.47	45,645.99	0.29	1
SW煤炭	1,296,363.14	1,285,733.15	10,629.99	0.17	2
SW交通运输	2,405,470.389	2,409,646.34	-4,175.95	-0.14	1
SW环保	2,471,266.43	2,458,560.87	12,705.56	0.14	-2
SW国防军工	7,416,265.43	7,388,295.34	27,970.09	0.10	1
SW钢铁	1,095,910.36	1,111,667.68	-15,757.32	-0.38	1
SW轻工制造	1,682,216.34	1,713,656.90	-31,440.55	-0.39	-3
SW汽车	8,064,360.56	8,233,873.77	-169,513.21	-0.54	1
SW商贸零售	1,777,843.70	1,824,429.85	-46,586.15	-0.56	-4
SW纺织服饰	1,324,700.97	1,359,557.24	-34,856.63	-0.59	-5
SW公用事业	5,775,665.91	5,942,064.39	-166,398.48	-0.67	-2
SW农林牧渔	2,159,796.25	2,220,603.07	-60,806.82	-0.71	-1
SW计算机	27,860,106.92	28,546,626.78	-686,519.86	-0.81	-2
SW房地产	1,776,445.14	1,842,009.67	-65,564.54	-0.87	-5
SW美容护理	439,086.67	459,751.36	-20,664.69	-0.99	-4
SW食品饮料	4,055,873.56	4,220,260.24	-164,386.68	-1.00	-1
SW社会服务	1,545,980.54	1,613,631.83	-67,652.57	-1.08	-2
SW综合	434,257.99	457,399.74	-23,141.75	-1.33	-3
SW石油石化	2,015,512.97	2,124,017.38	-108,504.41	-1.34	1
SW非银金融	6,494,917.86	6,772,080.15	-277,162.29	-1.40	-2
SW家用电器	2,916,643.28	3,084,486.84	-167,843.55	-1.68	-2
SW传媒	11,115,899.77	11,975,722.87	-859,823.10	-2.50	-3

资料来源：wind，华鑫证券研究

1.5、AI算力细分板块资金流向

AI算力相关板块资金流向情况：
上周印制电路板板块主力净流入244.97亿元，主力净流入率为5.00%，在8个子行业中排第1名；数字芯片设计板块主力净流出1.48亿元，主力净流入率为-0.02%，在8个子行业中排第8名。

图表7：8月3日-8月7日AI算力相关行业资金流向情况

行业	主力流入额(万元)	主力流出额(万元)	主力净流入额(万元)	主力净流入率(%)	连续流入天数
SW印制电路板	22,778,008.25	20,328,296.16	2,449,712.09	5.00	4
SW其他电源设备III	2,358,839.56	2,186,324.19	172,515.36	2.48	5
SW通信网络设备及器件	39,627,981.30	38,260,519.60	1,367,461.69	1.94	-1
SW集成电路封测	6,558,467.01	6,317,652.77	240,814.24	1.24	4
SW通信终端及配件	1,942,625.19	1,872,194.32	70,430.86	1.01	-1
SW其他计算机设备	4,332,369.92	4,203,030.22	129,339.70	0.94	-2
SW集成电路制造	3,306,447.46	3,288,841.82	17,605.64	0.19	3
SW数字芯片设计	40,387,282.79	40,402,054.29	-14,771.50	-0.02	1

资料来源：wind，华鑫证券研究

1.6、AI算力：PCB板块行情复盘

随着 5G 通信、人工智能、大数据中心、汽车电动化和智能化等新兴技术的快速发展对 PCB 的需求在数量和质量上都提出了更高要求。例如，5G 基站建设需要大量高频、高速 PCB 板以实现信号的高速传输；汽车智能化使得汽车电子系统日益复杂，对车用 PCB 的可靠性和性能要求大幅提升。

过去几十年，PCB 产业经历了从欧美向日本、台湾地区，再向中国大陆的转移过程。目前，中国大陆已成为全球最大的 PCB 生产基地，拥有完整的产业链和成本优势。未来，随着新兴市场的崛起，产业可能进一步向具有成本和技术优势的地区转移，同时供应链也将更加多元化和区域化。

PCB 行业呈现出一定的集中化趋势，头部企业在技术研发、资金实力、客户资源等方面具有明显优势，能够更好地应对市场变化和竞争挑战。头部企业通过不断扩大产能、提升技术水平和拓展市场份额，进一步巩固了其市场地位。

中低端PCB市场，由于进入门槛相对较低，竞争较为激烈，企业主要通过价格战来争夺市场份额。而在高端市场，如高多层板、高频高速板、封装基板等领域，技术壁垒较高，企业需要不断投入研发，提升产品质量和性能，以差异化竞争获取市场份额。

中国台湾拥有完善的PCB产业链，从上游的覆铜板、铜箔、玻纤布等原材料生产，到中游的PCB制造，再到下游的电子组装和应用，包括终端客户的认证等各方面都具备很强的优势和竞争力。完善的产业链配套体系使得台湾 PCB产业在全球范围内都具有很强的竞争力。因此，中国台湾PCB产业链上下游公司的营收具备一定的代表性，反映行业的发展趋势和景气度。

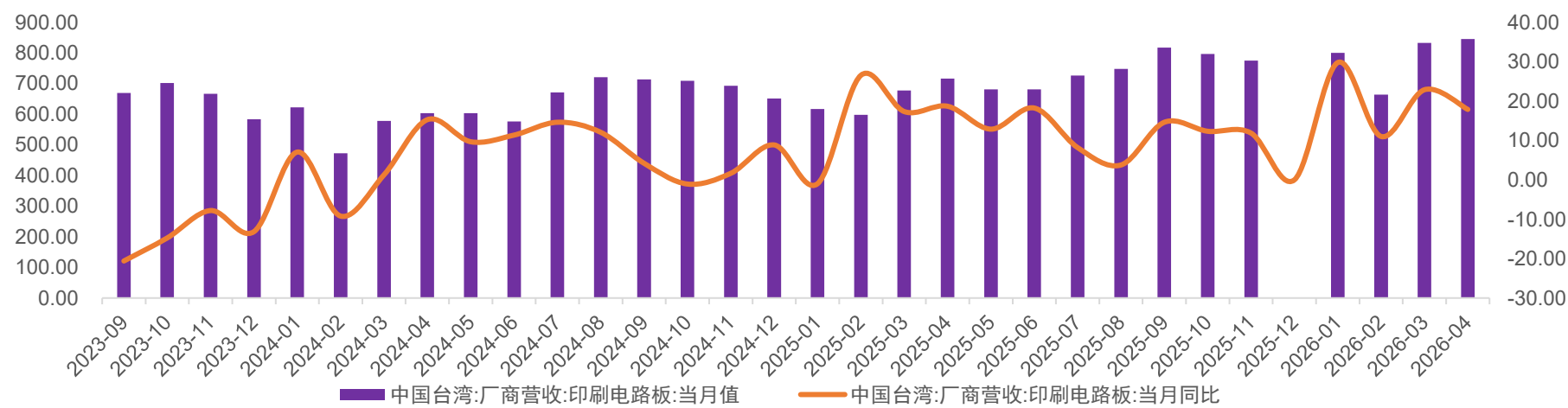
中游PCB厂商：从长期的维度来看，2023-2025年PCB行业经历了从衰退到复苏的阶段。2023年全年大部分月份营收同比增长率为负，行业处于衰退状态。但从2024年开始，同比增长率逐渐转正，行业进入复苏阶段，并在2025年行业整体实现了较为稳定的增长。这表明 PCB行业经历了一段下行时期之后，逐渐走出低谷，迎来了新的发展机遇。

1.6、AI算力：PCB板块行情复盘

从中期的维度来看，对比2024年和2025年的数据可以发现，行业从2024年初开始逐步复苏。2024 年 1 月台湾PCB厂商营收为 622.53 亿新台币，同比增长7.05%。2025年，台湾PCB厂商营收规模进一步扩大，增长率也保持在较高水平。尽管行业整体呈现增长趋势，但增长速度并不稳定。在2024年和2025年中，同比增长率都有较大幅度的波动，2024年2 月增长率为- 9.21%，之后又逐渐回升；2025年1月为- 0.99%，而2025年2月增长率为26.53%。波动的增长率反映出潜在的市场需求变化、季节性变化以及原材料价格波动等因素的影响。

从短期来看，下游AI算力需求旺盛带动AI-PCB需求提升。2025年各月营收当月值整体处于较高水平，除2024年2月为472.82亿新台币外，其余月份均在500亿新台币以上，且有个别月份超过 800 亿新台币。2025年11月，中国台湾PCB厂商营收达到774.72亿新台币，同比增长11.86%。2026年开年营收当月值处于较高水平，达到799.67亿新台币，同比增长29.77%。2026年4月当月值较开年营收进一步上升，达到845.58亿新台币，**同比增长17.87%**。

图表8：2023-2026年中国台湾印制电路板厂商营收及同比增速(亿新台币)



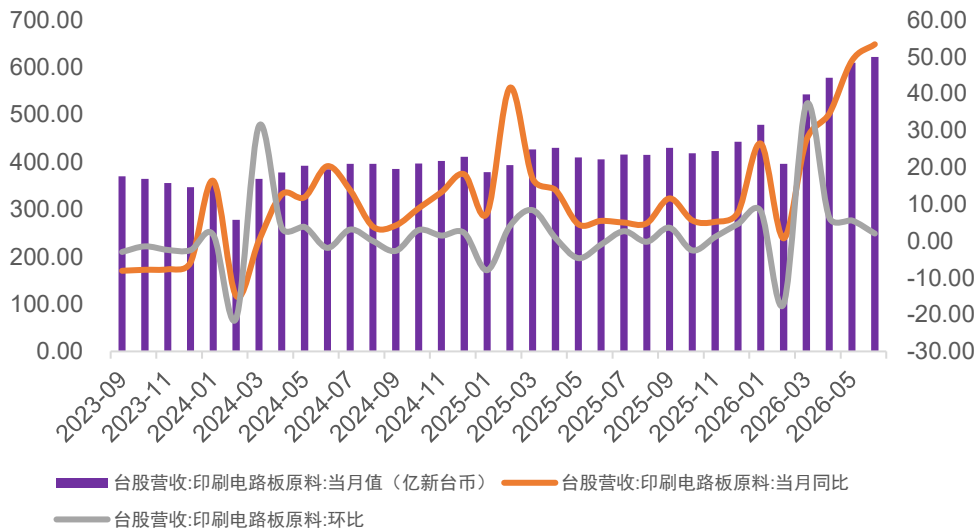
资料来源：wind，华鑫证券研究

1.6、AI算力：PCB板块行情复盘

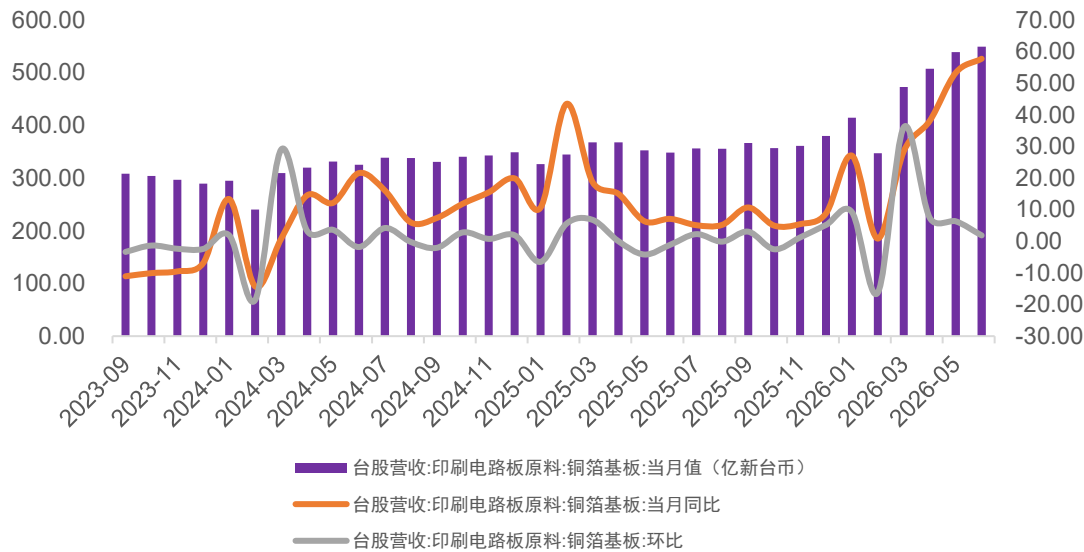
上游PCB基材厂商：5G、人工智能、汽车电子等新兴产业的发展对PCB上游基材提出新的要求，市场对于高频高速覆铜板和铜箔等材料的需求升级，M8-M9高频高速覆铜板和低表面粗糙度电子铜箔成为高端AI服务器的刚需。通常来说，PCB 上游基材的市场需求存在一定的季节性变化，第一季度通常是需求淡季，第四季度可能是需求旺季。

从最新的数据来看，2026年6月，中国台湾PCB原料厂商实现营收621.46亿新台币，同比增长53.36%，环比增长1.99%；中国台湾铜箔基板厂商实现营收548.69亿新台币，同比增长57.68%，环比增长1.83%。

图表9：2023-2026年台湾印制电路板原料厂商营收及增速（亿新台币）



图表10：2023-2026年台湾铜箔基板厂商营收及增速（亿新台币）

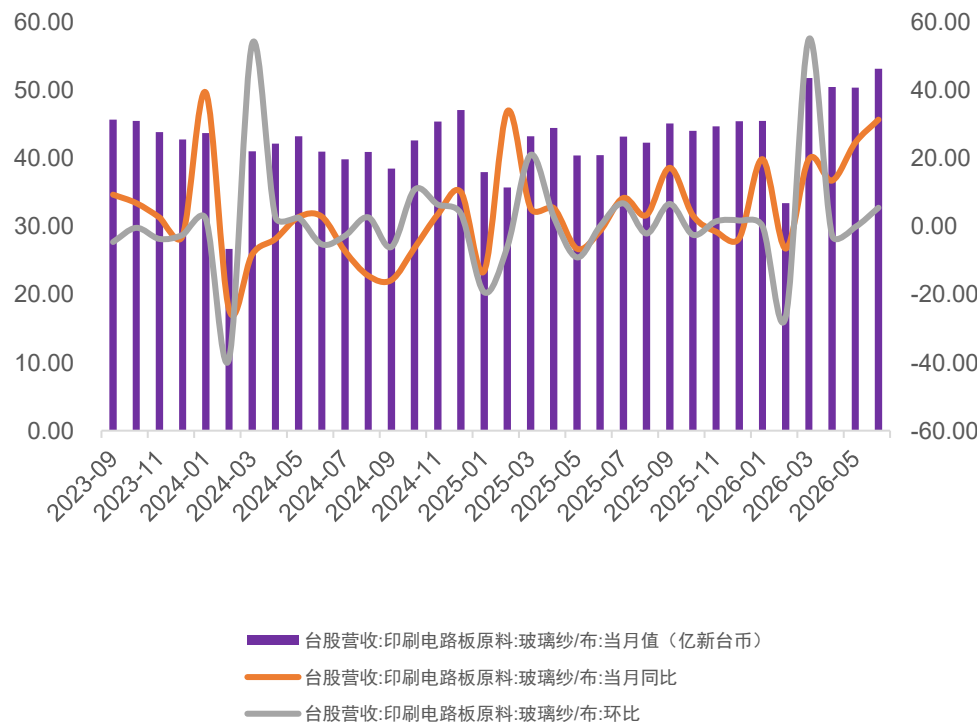


资料来源：wind，华鑫证券研究

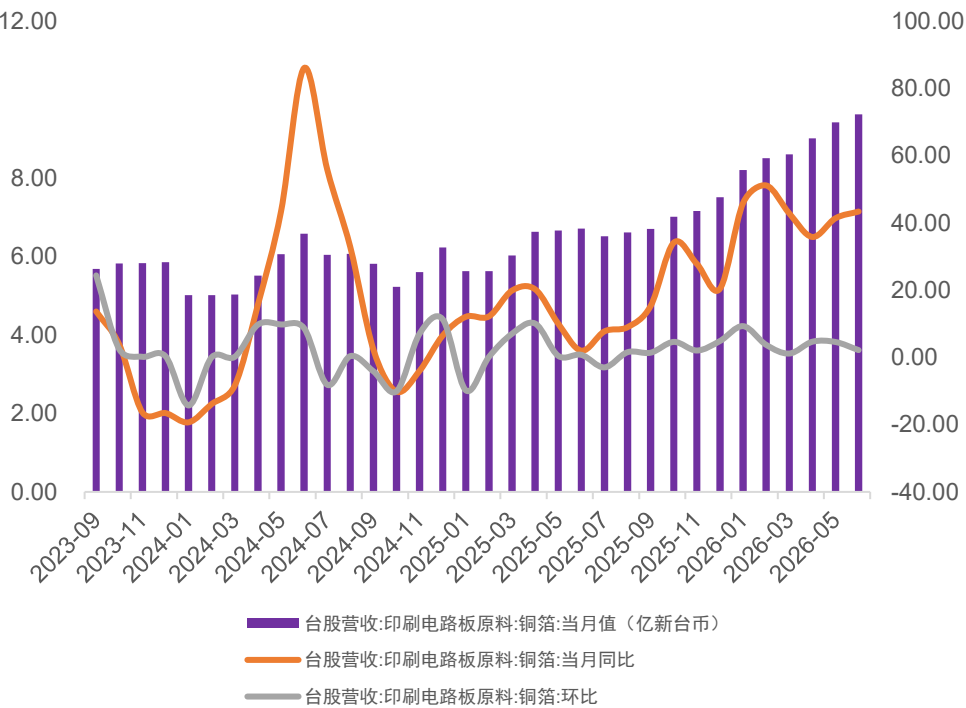
1.6、AI算力：PCB板块行情复盘

中国台湾电子布厂商实现营收53.19亿新台币，同比增长31.40%，环比增长5.52%；中国台湾电子铜箔厂商实现营收9.62亿新台币，同比增长43.37%；环比增长2.16%。

图表11：2023-2026年台湾电子布厂商营收及增速（亿新台币）



图表12：2023-2026年台湾电子铜箔厂商营收及增速（亿新台币）



资料来源：wind，华鑫证券研究

02 行业动态

研究创造价值

DeepSeek投资1.408亿元参与宇树科技IPO，共研人形机器人AI模型

据交易所公告显示，中国人工智能初创公司DeepSeek已向机器人制造商宇树科技投资1.408亿元人民币（约合2080万美元），并同意共同开发人形机器人的人工智能模型

DeepSeek获得了933,399股宇树科技（Unitree）股份，占上海IPO战略配售股份总数的2.31%。两家公司表示，将结合DeepSeek在人工智能模型方面的专长和宇树科技在机械工程、运动控制和具身智能方面的优势。宇树科技在采购模型训练服务和技术解决方案时将优先选择DeepSeek。公告还指出，DeepSeek在采购机器人或探索具身人工智能应用时也将优先选择宇树科技。此次合作旨在解决人形机器人开发者面临的一个关键瓶颈：构建能够理解陌生环境并可靠地将指令转化为实际动作的机器人“大脑”。

AI算力新动向：超大尺寸封装落地提速

当前最先进的AI系统依赖来自多工艺节点、多代工厂的裸片与芯粒（Chiplet），组成更大、更复杂的封装结构，这对先进封装技术提出了前所未有的要求。在2026年IEEE电子元件与技术大会（ECTC）上，英特尔晶圆代工的两支研究团队提出了互补方案以应对这一趋势：一支团队勾勒出下一代AI芯片封装的架构蓝图，另一支团队则攻克了封装尺寸扩大后出现的关键制造瓶颈。对于搭建AI平台的客户而言，这些技术进展意味着单系统计算密度更高、能效更优，且无需重构系统架构即可扩展下一代工作负载。

英特尔的先进设计团队阐述了最大尺寸达240mm×240mm的超大尺寸封装（HLFF）的设计与制造方案，可在单平台上集成计算裸片阵列、高带宽内存及I/O组件。与此同时，封装技术开发团队通过材料与工艺创新，以实现更大尺寸的封装。

数十年来，计算性能的提升主要依靠晶体管尺寸微缩。随着计算需求加速增长，单个封装内需集成更多组件，业界开始通过在封装层面整合多颗芯片、构建完整系统，来提升工艺节点的微缩性能。英特尔先进设计团队依托HLFF封装，将这一思路拓展至前所未有的规模。该设计通过EMIB-T（嵌入式多芯片互连桥接技术升级版）技术，连接计算裸片阵列、HBM与I/O组件。这类嵌入式硅桥可提供高密度互连，单通道数据传输速率超过64Gb/s。对系统设计者而言，相比多封装方案，该架构计算密度更高、延迟更低。

■ 诺基亚收购恩智浦北美工厂，布局磷化铟光芯片产线

当地时间8月5日，全球通信设备大厂诺基亚（Nokia）宣布签署最终协议，收购恩智浦（NXP）位于美国亚利桑那州的半导体厂。诺基亚计划将该厂转为磷化铟（InP）光芯片生产线，预计2029年第一季完成收购。而2027年年初将以租任部分厂房的方式先启动量产。这是通讯设备商直接买工厂自产芯片的罕见案例，显示诺基亚正加速转型为数据中心基础设施企业。

随着AI数据中心通信从传统铜线转向光纤，核心零组件的磷化铟光芯片需求暴增。其与运算储存用的硅不同，磷化铟能双向转换电信号与光信号，是光通讯设备核心。AI传输量暴增使具备超高频宽与速度的光通讯成为解决传输瓶颈的关键，根据市场调查数据显示，光收发器需求已达磷化铟供应量的两倍以上。

值得注意的是，AI芯片大厂英伟达（Nvidia）在2026年3月有向两大InP厂Coherent与Lumentum各注资20亿美元以确保磷化铟光芯片供应合约。Lumentum执行长指出，磷化铟短缺恐比内存更严重。因为相较过去电信客户数百个的订单，英伟达等AI巨头需求量高达数亿个。

诺基亚在2026年第二季净营收达48.15亿欧元，其中光通讯营收年增20%，AI与云端客户销售暴增105%，带动2026年股价大涨52.4%。目前，北美光网络市占自2024年的6.3%，攀升至2025年的27.3%，显示其市场爆发性。然而，市场分析师提醒，诺基亚尚未证明能达成市场所预期的高获利，且高利率环境恐影响数据中心建置速度，这些风险都是未来诺基亚运营的变数。

台积电3nm出货加速 Q4月冲18万片 2nm拼10万片

台积电先进制程产能布建再传捷报，美系投行Wedbush最新报告指出，受惠英伟达、AMD及博通等AI大厂强劲追单，台积电预计今年第4季初将3nm每月投片量提升至18万片，较上半年15万片增长，看好下半年出货动能加速；结合台积电官方2nm增长指引，市场估计2028年台积电2、3nm合计每月产能将突破40万片大关。

外资报告显示，台积电3nm今年第4季初达每月18万片投片量，比预期提前达阵。为因应客户需求，台积电持续赶工扩产，在台湾除了将部分5nm设备转换支援3nm外，也已宣布于台湾南科、美国亚利桑那州及日本熊本3地，同步建置3座全新3nm厂。

业界与研调机构估算，随着南科新厂预计明年上半年量产，美日2厂分别于明年下半年及2028年开出产能，到了2028年，台积电3nm晶圆每月投片量将攀升至22万至25万片。

在2nm方面，Wedbush分析师Matt Bryson指出，2nm2026年上半年每月投片约5万至6万片，第4季初升至8万片，年底朝10万片靠拢。

台积电资深副总侯永清先前在北美技术论坛透露，随着新竹与高雄共5座2nm厂放量，2026至2028年2nm产能年複合增长率将达70%，多家研调机构依此官方目标推估，2028年2nm月投片量将挺进18万片。

兆易创新连发两款MCU，加速切入机器人赛道

2026年8月5日，在具身智能机器人浪潮逐步迈向规模化落地的关键节点，兆易创新针对机器人市场发布了两款全新的32位微控制器（MCU）——GD32H77R系列和GD32F50MxxG系列。其中，GD32H77R系列是面向伺服驱动与机器人关节控制场景深度定制优化的专用MCU；GD32F50MxxG系列则是面向人形机器人、协作机械臂、灵巧手的高度集成的电机控制MCU。

兆易创新此次推出的两款新品，精准锚定了人形机器人市场，在功能定位上形成明确互补：其一以强大的算力与实时通信能力抢占性能高地，另一则以高度集成优势直击成本控制与空间受限的工程痛点，共同构建覆盖人形机器人关节控制全场景的芯片级解决方案。

当前机器人市场正处于爆发的前夜。根据高工机器人产业研究所（GGII）等机构数据，2025年全球人形机器人出货量约18,500台，而2026年预计将激增至近10万台，实现数倍增长。资本市场对于机器人赛道同样是热情高涨，2025年行业融资规模同比暴增216%至56.18亿美元，头部企业已进入IPO阶段，产业发展正驶入快车道。

目前，兆易创新已经服务了国内外超过300家机器人产业链上下游企业，客户覆盖了地平线、因时机器人、逐际动力、维他动力、珞石、松延机器人等行业内绝大多数知名厂商。据李孝剑透露，前兆易创新在机器人MCU市场的份额超过一半，上半年出货量已达约300万颗，下半年出货量预计更高。”

Anthropic宣布将自研AI芯片

8月6日消息，据路透社及Business Insider报道，美国人工智能（AI）技术大厂Anthropic近日发布一份招聘信息显示，该公司正在组建一支自研芯片设计团队，计划为Claude设计定制化的AI芯片。随后，Anthropic发言人也首次对外证实了这一消息。

根据曝光的招聘信息显示，Anthropic招聘的工程师职位要求应征者必须能展现自身对于半导体设计的定案和出货曾有“直接的个人贡献”。其中明确写道：“这是一个适合以下这种人的职位：曾经实际将芯片出货过、对时程安排抱持务实态度，并且能在背后没有一个大型组织支撑下，做出重大影响的判断抉择。”该职位的年薪范围为32万至48.5万美元。

Anthropic发言人随后向媒体证实，该公司正在筹组一支芯片团队，为Claude设计定制化AI芯片，将以协同设计（co-design）方式同时开发硬件和模型，让Claude得以在客户所需的规模上，更快速、更有效率地运行。Anthropic发言人还表示，Anthropic将持续采取一种多芯片并行的做法，包括来自亚马逊AWS、Google、英伟达、AMD的AI芯片供应。

目前Anthropic正面市场对Claude模型需求的大幅飚升，为此Anthropic除了持续采用英伟达和AMD的AI GPU芯片之外，也有采用AWS、Google的定制ASIC，虽然这样多元化的供应链策略有利于AI芯片采购成本的控制，但是Anthropic持续增长的算力需求，使得其面临的AI芯片采购数量和金额也在持续飙升，自研AI芯片自然也就成为了另外一条重要的降本增效路径，同时也能降低对于外部AI芯片供应商的依赖。

03 公 司 公 告

研究创造价值

■ 中科曙光：向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书

根据曙光信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书。

本次发行情况：

- 1、发行数量：本次发行可转债总额为人民币800,000.00万元，发行数量8,000,000手（80,000,000张）。
- 2、向原股东发行的数量和配售比例：本次发行向原股东优先配售4,071,021手，即4,071,021,000元，占本次发行总量的50.89%。
- 3、发行价格：按票面金额平价发行。
- 4、可转换公司债券的面值：每张面值人民币。
- 5、募集资金总额：人民币800,000.00万元。
- 6、发行方式：本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2026年7月14日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐人（主承销商）包销。
- 7、配售比例：原股东优先配售4,071,021手，总计4,071,021,000元，占本次发行总量的50.89%；网上社会公众投资者实际认购3,877,027手，即3,877,027,000.00元，占本次发行总量的48.46%。保荐人（主承销商）包销可转换公司债券的数量合计为51,952手，包销金额为51,952,000.00元，占本次发行总量的0.65%。

智微智能:关于调整向特定对象发行A股股票发行数量上限的公告

根据深圳市智微智能科技股份有限公司关于调整向特定对象发行A股股票发行数量上限的公告。

深圳市智微智能科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票发行数量上限由“不超过75,688,726股（含本数）”调整为“不超过98,109,825股（含本数）”。除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。

公司股本变动情况：

1. 公司于2026年6月23日披露了《2025年年度权益分派实施公告》，2025年年度权益分派方案为：以截至2026年4月22日总股本252,290,610股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），同时以资本公积每10股转增3股。预案公布后至实施前，如公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，则以实施利润分配及资本公积金转增股本方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配及转增比例固定的原则对分配及转增总额进行调整。

自2025年年度利润分配预案披露至实施期间，公司因部分股票期权行权登记共5,146股，公司总股本由252,290,610股变更为252,295,756股。根据上述每股分配及转增比例不变调整分配及转增总额的原则，公司以总股本252,295,756股为基数进行权益分派，共计转增75,688,726股，转增后公司总股本将增加至327,984,482股。截至本公告披露日，公司2025年年度权益分派已实施完毕。

2、2026年5月18日，公司2025年度股东会审议通过了《关于回购注销剩余限制性股票的议案》。2026年7月3日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购数量的议案》，回购数量由73.2100万股调整为95.1730万股，公司本次限制性股票回购注销事宜已于2026年7月31日办理完成，公司总股本由327,984,482股变更为327,032,752股。

奥飞数据:关于控股股东权益变动触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公告

根据广东奥飞数据科技股份有限公司关于控股股东权益变动触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司于2026年4月24日披露了《关于控股股东减持股份的预披露公告》持有公司股份271,925,507股（占公司总股本比例27.60%）的公司控股股东广州市昊盟计算机科技有限公司计划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即2026年5月21日至2026年8月20日）以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份不超过20,622,900股（占公司总股本比例2.09%）。

公司于近日收到控股股东昊盟科技出具的《关于股份减持计划完成告知函》，昊盟科技于2026年8月4日至2026年8月5日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份8,807,681股、于2026年8月5日通过大宗交易方式减持公司股份11,815,000股，合计减持公司股份20,622,681股，占公司总股本比例为2.09%。本次权益变动后，昊盟科技持有公司股份251,302,826股，占公司总股本比例为25.51%，权益变动触及1%整数倍，本次减持计划已实施完毕。

工业富联:关于股份回购进展公告

根据富士康工业互联网股份有限公司关于股份回购进展公告。

一、 回购股份的基本情况

富士康工业互联网股份有限公司于2026年7月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。公司拟使用自有资金不低于人民币10亿元（含）且不超过人民币20亿元（含），以集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份的价格不超过人民币103元/股，本次回购股份的目的系维护公司价值及股东权益，所回购股份将按照有关规定用于出售，逾期未实施出售的部分将依法予以注销。回购股份实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过3个月。具体内容详见《富士康工业互联网股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》

二、 回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定：回购股份期间，上市公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份情况公告如下：

截至2026年7月31日，公司尚未实施股份回购。

三、 回购方案的变更或终止

截至公告日，公司回购方案不存在变更或终止的情况。

04 风 险 提 示

研究创造价值

中美“关税战”加剧风险

中美科技竞争加剧风险

先进制程进度不及预期风险

AI模型大厂资本开支不及预期风险

庄宇：清华大学硕士，金融学&工科复合背景。10年科技行业研究经验。立足产业，做深入且前瞻的研究，主要覆盖AI硬件领域。

何鹏程：悉尼大学金融硕士，中南大学软件工程学士，曾任职德邦证券研究所，2023年加入华鑫证券研究所。专注于半导体、PCB行业。

张璐：早稻田大学国际政治经济学学士，香港大学经济学硕士，2023年加入华鑫证券研究所，专注于光通信、存储等领域研究。

石俊烨：香港大学金融硕士，新南威尔士大学精算学与统计学双学位，研究方向为PCB方向。

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

免责声明

华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”）具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。本报告由华鑫证券制作，仅供华鑫证券的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告中的信息均来源于公开资料，华鑫证券研究部门及相关研究人员力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。我们已力求报告内容客观、公正，但报告中的信息与所表达的观点不构成所述证券买卖的出价或询价的依据，该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时结合各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就财务、法律、商业、税收等方面咨询专业顾问的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华鑫证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露。

本报告中的资料、意见、预测均只反映报告初次发布时的判断，可能会随时调整。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期，华鑫证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。华鑫证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。

本报告版权仅为华鑫证券所有，未经华鑫证券书面授权，任何机构和个人不得以任何形式刊载、翻版、复制、发布、转发或引用本报告的任何部分。若华鑫证券以外的机构向其客户发放本报告，则由该机构独自为此发送行为负责，华鑫证券对此等行为不承担任何责任。本报告同时不构成华鑫证券向发送本报告的机构之客户提供的投资建议。如未经华鑫证券授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。华鑫证券将保留随时追究其法律责任的权利。请投资者慎重使用未经授权刊载或者转发的华鑫证券研究报告。

证券投资评级说明

股票投资评级说明：

	投资建议	预测个股相对同期证券市场代表性指数涨幅
1	买入	>20%
2	增持	10%—20%
3	中性	-10%—10%
4	卖出	<-10%

行业投资评级说明：

	投资建议	行业指数相对同期证券市场代表性指数涨幅
1	推荐	>10%
2	中性	-10%—10%
3	回避	<-10%

以报告日后的12个月内，预测个股或行业指数相对于相关证券市场主要指数的涨跌幅为标准。

相关证券市场代表性指数说明：A股市场以沪深300指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以道琼斯指数为基准。



华鑫证券
CHINA FORTUNE SECURITIES

研创造价值